

Table of Contents

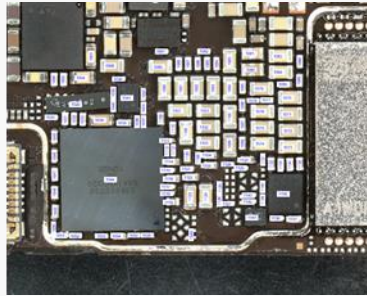
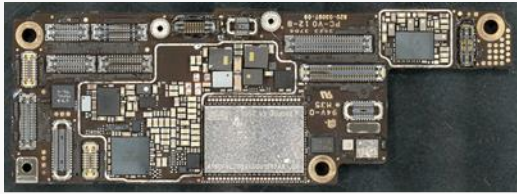
		Page
1. Product Overview	3
2. Taking out PCB	5
3. Removing Interposer and Shield	6
4. Polishing each layer	8
5. Parts Position	48
6. Parts List	55



○レポートアウトプット

1. 全てのMLCCとその他素子を認識し部品No.を設定

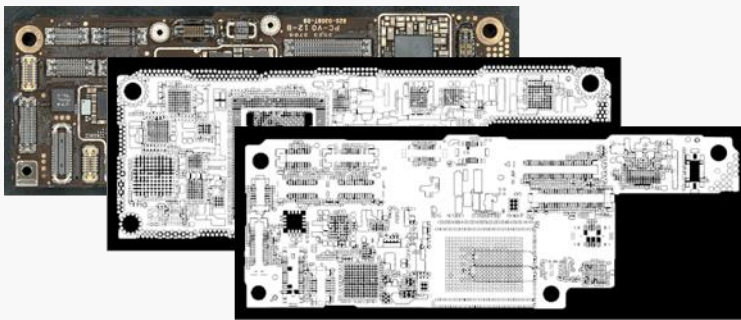
全てのMLCCの容量測定を行いました。その他部品はPKGマーキングとデータシートから製品情報を調査しリスト化した。



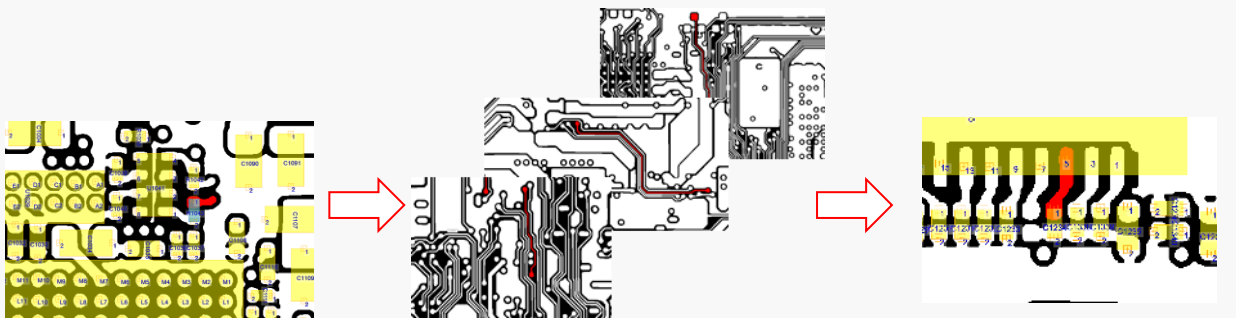
部品No.	部品名	容量	測定値	備考
C100	MLCC	100nF	100nF	
C101	MLCC	100nF	100nF	
C102	MLCC	100nF	100nF	
C103	MLCC	100nF	100nF	
C104	MLCC	100nF	100nF	
C105	MLCC	100nF	100nF	
C106	MLCC	100nF	100nF	
C107	MLCC	100nF	100nF	
C108	MLCC	100nF	100nF	
C109	MLCC	100nF	100nF	
C110	MLCC	100nF	100nF	
C111	MLCC	100nF	100nF	
C112	MLCC	100nF	100nF	
C113	MLCC	100nF	100nF	
C114	MLCC	100nF	100nF	
C115	MLCC	100nF	100nF	
C116	MLCC	100nF	100nF	
C117	MLCC	100nF	100nF	
C118	MLCC	100nF	100nF	
C119	MLCC	100nF	100nF	
C120	MLCC	100nF	100nF	

2. プリント基板全層の配線レイアウトを抽出し各層のレイアウトデータを作成

ナンバリングされた全てのMLCCと、その他素子をレイアウトデータ上に配置し回路(接続情報)を明確にした。



3. 各MLCCの回路(接続情報)が明確にわかるビューソフトを提供します。



任意の素子を選択すると

素子と接続している
各層配線の接続経路を表示

素子の接続情報をハイライト表示

